

公司代码：688045

公司简称：必易微

深圳市必易微电子股份有限公司
2025年年度报告摘要



必易微
Kiwi Instruments

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本年度报告中描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分，请投资者注意投资风险。

3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2025年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），不送红股，不进行资本公积转增。公司通过回购专用账户所持有的公司股份不参与本次利润分配。

公司2025年度利润分配方案已经公司于2026年3月13日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

母公司存在未弥补亏损

适用 不适用

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

适用 不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称

人民币普通股 (A股)	上海证券交易所 科创板	必易微	688045	/
----------------	----------------	-----	--------	---

1.2 公司存托凭证简况

适用 不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高雷	李雪
联系地址	深圳市南山区西丽街道西丽社区打石二路万科云城六期一栋云中城 B3303	深圳市南山区西丽街道西丽社区打石二路万科云城六期一栋云中城 B3303
电话	0755-82042719	0755-82042719
传真	0755-82042192	0755-82042192
电子信箱	ir@kiwiinst.com	ir@kiwiinst.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

公司所处行业为集成电路设计行业，主营业务为高性能模拟及数模混合集成电路的设计和銷售，产品布局全面，借助于严格的质量管理体系和产业资源优势，已成为国内领先的拥有丰富产品及完整解决方案的芯片设计企业。

公司主要产品分为电源管理、电机驱动、电池管理、信号链及微控制器五大类，具体如下：

1、电源管理

(1) AC-DC 芯片，是将输入交流市电转换为特定的直流输出电压，给终端设备稳定、可靠、高效地供电，主要应用在各种充电器、适配器、家用电器、工业电源、数据中心电源等领域。

(2) DC-DC 芯片，是将一个直流电压转换为目标所需直流电压的电源控制器。公司目前 DC-DC 产品已覆盖大部分消费电子、工业控制、智能物联、数据中心及汽车等应用。

(3) 驱动芯片，用于驱动、控制器件及模组的工作状态，可分为 LED 驱动芯片、栅极驱动芯片等：

1) LED 驱动芯片，是驱动和控制 LED 电流功能的芯片，通过直接或间接检测负载电流并与参考基准比较的方式去调节开关频率或开关管的导通时间，实现对 LED 所需电流的控制，属于恒流驱动芯片，主要应用于通用照明、智能照明、中大功率商业及工业照明、LED 背光等。

2) 栅极驱动芯片，主要为各类功率器件（例如 IGBT、MOSFET、GaN FET、SiC FET 等）提供栅极驱动的专用芯片，是实现各类电力电子拓扑的基础芯片。公司产品根据隔离方式可分为非隔离型驱动芯片与隔离型驱动芯片，根据驱动方式可分为电压型驱动芯片和自适应电流型驱动芯片，主要面向工业、新能源、通讯、数据中心、汽车等应用。

(4) 线性电源芯片，是一种直流线性电压调节器，输入电压能够被其调节为特定的比输入电压小的输出电压。LDO 为线性电源芯片的一种，相比传统方案，LDO 可将压差调节至更小的水平。LDO 能保护电路中其他部件免受外界噪声造成的电压、电流突变造成的损害，低压差、低噪

声等特性使得 LDO 在工业、医疗、汽车、航空航天和消费电子等领域广泛应用。公司目前主要研发方向为高压智能/超低静态功耗/低压大电流等高性能线性电源芯片。

2、电机驱动芯片，指集成有 CMOS 控制电路和 DMOS 功率器件的芯片，根据输入信号，按照内置的算法控制电机绕组电路流动方向，从而控制电动机的启停与转动方向，交流感应电机无需特殊驱动装置即可旋转，而直流无刷（BLDC）、步进以及伺服电机都需要驱动器来进行工作。公司产品涵盖交流电机驱动芯片、直流有刷电机驱动芯片、直流无刷电机驱动芯片、步进电机驱动芯片，以及由“前端 MCU+栅极驱动+功率器件以及各类外围器件”构成的 SoC 方案，用于实现各类电机的控制、驱动与保护，可广泛应用于家用电器、园艺工具、机器人、智能制造、工业自动化、数据中心、汽车电子等领域。

3、电池管理芯片，公司布局的产品覆盖了电池保护芯片、模拟前端芯片、电量计芯片及充电管理芯片，形成完整的电池管理系统解决方案，主要应用于便携式、可穿戴电子产品、电动工具、园艺工具、无人机、动力电池组、户用储能、工商业储能等领域。

（1）模拟前端芯片、电池保护芯片主要用于电池状态监控和电池单体均衡以避免出现过充、过放、过流和短路等故障。针对高串数应用，公司推出多款最高至 18 串电池管理系统应用的高边/低边驱动 BMS AFE 芯片，内置高精度电压检测 ADC 和电流检测 ADC，集成电池均衡。对于低串数应用，公司推出 3~5 节低功耗电池组保护芯片，内置高精度电压检测电路和电流检测电路，广泛应用于电动工具、后备电源等各类应用场景；同时推出 3~5 节高集成、高精度监控器和保护器，内置高精度的监控系统、灵活配置的保护子系统以及电池均衡，广泛应用于 12V 电池组、电动和园艺工具等应用场景。

（2）电量计芯片能够测量和记录电器、设备或系统的电能消耗。公司已推出多款单节电压型高性价比电量计，广泛应用于移动电源、运动相机、电脑/笔记本外设、无线蓝牙耳机、手环、手机等消费电子产品。

（3）充电管理芯片可实现电压转换、调节，电池充电管理以及过压过流保护等功能。公司产品涵盖多款电子雾化控制芯片、开关降压型充电管理、线性充电管理，广泛应用于便携式、可穿戴电子产品。

4、信号链

（1）传感器，是一种能把现实中的光、温度、湿度、压力、磁、电流等物理或化学量转变成便于利用的模拟电信号的器件，涵盖十分广泛，如温度传感器、压力传感器、电流传感器、磁传感器、光传感器等，公司主要布局磁传感器、电流传感器等，具体如下：

1) 电流传感器，基于线性霍尔效应实现磁电转换，通过检测聚磁环缺口处磁场变化，芯片将垂直磁场按比例转化为电压输出，反映原边电流变化。公司产品具有高集成、高可靠的特性，同时一致性较强，根据不同客户的需求分为 0-50A、0-400A、0-1000A 三档，主要应用于新能源汽车、工业控制、机器人、新能源发电及电网、储能系统等。

2) 磁传感器，磁传感器是“磁-电”信号转换的核心元件，可用于位移、角度、电流等参数的测量。公司产品覆盖位置传感器、开关传感器、角度传感器、轮速传感器、电子罗盘等，并根据客户需求可集成磁编码器以及编程功能，凭借非接触测量、高可靠性、特殊封装等优势，已渗透至汽车电子、机器人、数据中心等核心场景。公司产品从技术角度主要分为霍尔传感器(Hall Effect)和磁阻效应传感器(xMR)：

①霍尔传感器：霍尔传感器基于霍尔效应，借助霍尔元件将垂直磁场、电流等变化转化为电信号，能够进行高/低电平数字信号输出，便于后端驱动器和微控制器进行数据处理，因此被广泛应用于各种白色家电、工业设备、新能源汽车：

②磁阻效应传感器：磁阻效应是指半导体材料通电后，其电阻值随外部磁场变化而改变，可

检测平行或特定方向的磁场。公司的磁阻技术涵盖异向磁阻（AMR）、巨磁阻（GMR）、隧穿磁阻（TMR），具有高精度、高灵敏度、低功耗等特点，可用于工业手臂、机器人关节/灵巧手、AR/VR、无人机、医疗和探矿等领域。

（2）放大器，包括运算放大器、差分放大器、电流检测放大器等。信号放大是模拟信号处理最常见的功能，在各类电子电路应用中十分广泛，一般通过运算放大器连接成专用的放大电路来实现。公司主要产品为高压放大器、高精度放大器、低功耗放大器、隔离型放大器等，应用于工业自动化、仪器仪表、数字电源、光伏、汽车及可穿戴电子产品等。

（3）转换器，用来完成模拟信号和数字信号的相互转换，包括模数转换（ADC）和数模转换（DAC）两种。公司主要布局高精度、低功耗、多通道等数模转换器，面向工业自动化、通讯设备、医疗设备、电网电力、仪器设备等领域。

（4）隔离芯片，是将输入信号进行转换并输出，以实现输入、输出两端电气隔离的一种安规器件。公司主要布局数字隔离芯片，并且能够与栅极驱动芯片、接口芯片、运算放大器等形成隔离驱动、隔离接口、隔离采样等高性能、多功能芯片方案，主要面向信息通讯、电力电表、光伏储能、新能源汽车等各个领域。

（5）接口芯片，是基于通用和特定协议且具有通信功能的芯片，广泛应用于电子系统之间的信号传输，可提高系统性能和可靠性。接口芯片分为隔离与非隔离两种，公司在 USB&Type-C、I2C、隔离 RS-232/485、隔离 CAN 等不同接口标准均有布局，其中在 USB&Type-C 方面已推出产品并成功量产。

5、微控制器

微控制器（MCU）是芯片级的计算机，又称单片机，是把中央处理器（CPU）的频率与规格做适当缩减，并将内存（Memory）、计数器（Timer）、USB、A/D 转换、UART、PLC、DMA 等周边接口都整合在单一芯片上，形成具有控制功能的芯片级计算机。

MCU 分类方式众多，从 MCU 位数（位数是指 MCU 每次处理数据的宽度，位数越高，MCU 数据处理能力越强）来看，可分成 8 位、16 位、32 位等。其中，8 位 MCU 成本低、便于开发，性能可以满足大部分场景需要，被广泛应用于消费、工业控制、家电和汽车（比如汽车风扇、雨刷天窗等）等下游领域。而 32 位 MCU 运算能力更强，能满足高速处理的需求，多用于解决复杂场景问题（比如空调控制系统、工业机器人、汽车智能座舱、车身控制等）。

公司 MCU 产品按照位数可分为 8 位及 32 位 MCU，具体如下：

（1）8 位 MCU。公司 8 位 MCU 产品使用 8051 内核处理器，支持四种通信模式，包括 UART、SPI、简易 I2C（主模式）和 SYNC，集成 LCD 驱动及 32KHz 内部低速时钟（±1%精度-全温范围），支持内部升压/电容分割/外部电阻分割的切换，显示功耗低至 7μA，主要应用于空调遥控器、智能玩具、电动工具、IoT 等低功耗场景；

（2）32 位 MCU。公司 32 位 MCU 可分为通用 MCU、高性能 MCU、电机控制 MCU、AI MCU。

1）通用 MCU。通用 MCU 产品使用 M0+ 内核处理器，集成 2.4-5.5V 电源、12 位 ADC、定时器、存储器、DMA、外设接口等模块，最大支持 6 对互补输出、11 通道 PWM 输出，应用于空调内机、冰箱主机、洗衣机、智能净水机、微波炉、烟雾报警器等；

2）高性能 MCU。高性能 MCU 产品使用 M4 内核处理器，可分为单芯片系列和集成预驱系列。

①单芯片系列集成 2.4-5.5V 电源、2 个高速 12 位 ADC、定时器、存储器、DMA、时钟、外设接口等模块，支持无感 FOC 控制，同时支持 3 个独立的电机控制以及 3 个交错的 PFC 控制，应用于空调外机、冰箱压缩机、洗衣机压缩机、洗碗机、吸尘器、E-bike、DC-DC 电源、逆变器、

充电桩等；

②集成预驱系列可集成耐压最高 600V 的三相门极驱动，支持霍尔传感器、多路 ADC 采样（2.4M 采样率）及过流、过温、欠压保护，主要应用于空调内风机，空调外风机，洗衣机，吸尘器，空气净化器，暖风机等。

3) 电机控制 MCU。电机控制 MCU 产品使用 M0+内核处理器，可分为单芯片系列、集成预驱系列和全集成系列。

①单芯片系列集成 2.4-5.5V 电源、12 位 ADC、定时器、存储器、HAU、时钟、外设接口等模块，最大支持 8 通道 PWM 输出，可支持多种安全模式，广泛应用于电机控制和应用、家电控制、工业应用等；

②集成预驱系列可集成 40V/200V/600V 驱动，内置过流、过温、欠压保护，支持多路 ADC 采样以及方波、正弦波、FOC 控制算法，并可以单 PIN 升级，可用于空气净化器、高速风筒、热水器、油烟机、风扇灯、落地扇、电动工具、其他电机驱动等；

③全集成系列可集成耐压最高 600V 的三相门极驱动，支持霍尔传感器、多路 ADC 采样及过流、过温、欠压保护，能够运行方波、正弦波控制算法，并可以单 PIN 升级，主要应用于空调内机，空调外机，冰箱，洗碗机，空气净化器等。

4) AI MCU。AI MCU 使用“CPU+NPU”双核，支持浮点、定点精度及 DNN/CNN 模型，集成高精度变频控制、采样率 2.4Mbps 高速 ADC，拥有高可靠性，是基于 AI 策略的系统控制技术以及机器学习、节能算法形成的“AI+变频控制”单芯片解决方案，应用场景为空调、冰箱、洗衣机、新能源汽车等。

2.2 主要经营模式

公司采用集成电路行业典型的 Fabless 模式，专注于集成电路芯片的设计和 sales，生产主要采用委托加工模式。具体如下：

1、研发模式

在 Fabless 经营模式下，集成电路的研发环节是公司业务的核心，公司设立了设计部、系统应用部、工艺版图部、品质与工程部等。设计部按产品规格和工艺规则设计电路内部参数，系统应用部负责定义产品规格与产品验证，工艺版图部负责制定工艺规则及版图设计，品质与工程部负责测试程序设计以及可靠性考核。同时，公司针对不同的产品线设立产品线经理。产品线经理负责对应产品线的整体规划，同时协调各资源部门推进新产品研发进程。

2、营运模式

公司采用集成电路行业典型的 Fabless 模式，通过委托加工的方式将自主研发的集成电路版图委托晶圆制造厂商进行晶圆制造后委托中测厂商进行晶圆中测，中测完成后晶圆委托封装和成品测试厂商进行封装和成品测试，完成芯片的采购及生产流程。公司制定了严格的供应商管理制度，以确保供应商所提供的产品或服务符合公司的相关要求。

3、销售模式

公司采用“经销为主，直销为辅”的销售模式，即公司主要通过经销商销售产品至终端客户，辅向以部分终端客户直接销售产品的模式。在经销模式下，公司与经销商之间进行买断式的销售，同时公司会对经销商进行信息收集和统一管理；在直销模式下，公司将产品直接销售至终端客户。

2.3 所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司所处行业属于“软件和信息技术服务业（I65）”，根据《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016）》，公司所属行业为“1 新一代信息技术产业”中的“1.3 电子核心产业”之“1.3.1 集成电路”；根据《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所属行业为“1.3 新兴软件和新型信息技术服务”中的“1.3.4 新型信息技术服务”中的“集成电路设计”。

集成电路的下游应用领域市场广泛，随着消费电子、工业控制、智能物联、数据中心、新能源汽车等终端应用市场的不断发展，全球集成电路市场的需求量稳步提升。预计未来几年，伴随着以 AI、新能源、5G、IoT、车联网和云计算为代表的新技术的推广，更多产品和场景将需要植入芯片、存储器等集成电路元件，集成电路产业将会迎来进一步发展。根据 WSTS 数据，2025 年全球半导体销售额同比增长 25.6%至 7,917 亿美元，预估 2026 年全球半导体市场销售额继续保持强劲增长，将同比增长 26.3%，实现 9,750 亿美元。受益于全球半导体产业链第三次转移以及国内制造业的成长，中国国内各应用领域对国产集成电路产品的使用需求日益增长，同时在中央和各级政府一系列产业支持政策的驱动下，国内集成电路行业得以快速成长。据 Omdia 2026 年 1 月最新报告，2026 年中国半导体市场规模将达 5,465 亿美元，同比增长 31.26%，显著高于全球平均水平，占全球市场比重超 55%，持续稳居全球第一大半导体市场地位。

公司主营业务为高性能模拟及数模混合集成电路的设计和銷售，下游应用场景丰富，覆盖消费电子、工业控制、智能物联、数据中心、汽车电子等相关领域。2024 年开始，集成电路产业链从去库存到补库存转变，中国半导体国产升级加速，全球市场竞争加剧，行业并购活跃，整体朝着技术创新、规模扩张和国产替代加速的方向发展。根据 Frost&Sullivan 数据，2025 年全球信号链和电源管理领域的模拟芯片市场规模将达到 5,917 亿元，其中，中国的市场规模将达到 2,203 亿元；到 2029 年全球市场将达到 8,035 亿元，中国市场将达到 3,346 亿元。相较于巨大的市场需求，国产模拟集成电路仍然处于销售规模较小、自给率较低的状况，进口替代的空间巨大。越来越多的本土厂商通过持续的研发投入和产品、技术升级，在技术研发与产品市场导入方面实现了快速成长，在汽车、工业、通讯等相关的新兴产业不断寻求更大的市场空间。

近年来，生成式 AI、新能源汽车、5G、IoT 等新兴技术的持续发力，将为整个市场带来强劲动力，为模拟芯片等细分市场带来巨大机遇。这一发展趋势下，市场对模拟芯片的要求愈发提升，难度更高、更符合需求、集模拟电路和数字电路处理于一体的数模混合芯片（微控制器、传感器、SoC、ASIC）愈发受到重视。公司大力拓展了微控制器/数字信号处理器、传感器等数模混合芯片的研发布局。微控制器（MCU）作为嵌入式系统的核心组件，凭借其强大的控制能力和广泛的适用性，在家用电器、工业控制、汽车电子、手机、可穿戴设备、物联网等众多领域中扮演着不可或缺的角色。近年来，全球 MCU 市场虽然有过较为低迷的时段，但整体展现出增长势头，Yole 的研究报告显示，2023 年全球 MCU 市场规模约为 282 亿美元，预计至 2028 年，将以 5.5% 的年复合增速达到 388 亿美元，到 2030 年更有望攀升至 582 亿美元，其增长潜力不容小觑。其中，中国 MCU 市场随着国内产业升级、智能制造战略的深入推进，以及物联网、汽车电子等领域的快速发展，市场需求旺盛。预计到 2025 年，中国 MCU 市场规模将超过 3,000 亿元，并成为全球 MCU 产业增长的重要引擎。根据 Frost&Sullivan 数据，中国传感器市场规模 2024 年为 2,725 亿人民币，预计 2025-2029 年 CAGR 为 18.2%。工业领域传感器市场的发展主要受益于工业自动化、智能化发展的影响，智能工厂产线大规模导入机器人、AGV、检测设备、数控设备等，对各类传感器的需求量大幅增加。在供应链安全与自主可控的国家战略指引下，下游工业设备制造商、机器人集成商对国产高性能传感器的验证和导入意愿显著增强，高端产品国产化进程将受益于增量市场空间爆发。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司主营业务为高性能模拟及数模混合集成电路的设计和銷售，主要产品为电源管理、电机驱动、电池管理、信号链及微控制器芯片，覆盖 AC-DC、DC-DC、驱动 IC、电机驱动、线性稳压器、电池管理、电流传感器、磁传感器、放大器、转换器、隔离芯片、接口芯片、微控制器等多个产品类型，并提供一站式芯片解决方案和系统集成服务。

公司以电源管理、电机驱动、电池管理为核心，融合感知与控制技术，将“独特创新，易于使用”的公司理念融入到每颗芯片、每套算法、每行代码里，在电源管理、电机驱动、电池管理系统上构筑了深厚的技术和市场壁垒，通过“三电+感知+控制”的完整链路，形成稳固的技术领先地位与强大的产品矩阵，赢得了持续且强劲的市场竞争力。

公司产品性能处于模拟芯片行业领先的水平，尤其在电源管理领域，公司的技术水平突出，许多核心产品的综合性能已经达到了国际标准。同时，公司是国内领先的已实现高串数电池管理系统 AFE 芯片技术突破的本土企业之一，产品可覆盖 110V 以内储能及电池系统应用，是国内少有的在内/外储能、动力电池组、无线基站等应用上成功量产的案例。而在电机驱动领域，公司拥有“前端 MCU+栅极驱动+功率器件以及各类外围器件”组成的 SoC 方案，推出数款“All-In-One”芯片，用于实现各类电机的控制、驱动与保护，并能够提供核心算法，技术实力得到行业标杆客户的一致认可。

2025 年，公司完成了对兴感半导体的并购，通过严格的质量管控体系和特殊封装测试技术，其电流传感器、磁传感器等产品已达到车规级、航天级应用要求，并实现批量供货，进一步加强了公司的技术实力和行业地位。

基于对公司研发及产业化能力的认可，公司获得“2025 中国 IC 设计 Fabless 前 100”、“国产模拟 IC 行业-卓越奖”、“2025 全球电子成就奖-年度微控制器/接口产品”等奖项。

凭借领先的研发实力、可靠的产品质量和优质的客户服务，公司产品已进入众多行业头部客户的供应链体系，应用范围涵盖能源与电力、家居家电、工业自动化、智能物联等众多领域。公司将继续紧跟客户需求和技術发展趋势，利用研发能力及头部客户等优势，不断拓展新的产品布局及核心技术，致力于为用户提供高效能、低功耗、高可靠性、高集成度、稳定品质的产品和完整的解决方案，推动模拟芯片行业的性能提升和技术升级，进一步巩固提升公司在行业中的领先地位和竞争力。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

近年来，随着新能源汽车、工业自动化、物联网、智能设备以及电子设备的应用和普及，人工智能应用、大数据、自动驾驶等新兴产业的逐渐发展，终端应用设备和市场对模拟芯片的性能、体积、设计均提出了更高的要求，模拟芯片行业向着集成化、差异化、数字化、智能化等方向发展。

(1) 集成化

随着人们对电子设备便携度要求的不断提高，产品外形及体积变得更轻更薄。这些日益增长的需求对便携式设备的电子电路系统提出了更高的要求，既要减小设备的尺寸，又要保持较高的

转换效率。对于模拟及数模混合芯片在更小空间的应用和更小尺寸的终端产品下，可以满足同等甚至更高功率效率的需求，已成为行业发展的方向。

(2) 差异化

随着国产替代的浪潮不断推进，国内新兴模拟芯片公司如雨后春笋般成立，但大多数公司起步时都是采取“内卷”通用模拟芯片来快速获取现金流的方式，组建专业研发团队、转向设计专用模拟芯片、提高产品的技术门槛，面向工业自动化、物联网、新能源汽车等新兴应用领域走专用化、差异化、应用高端化路线是国内模拟芯片行业下一步发展的趋势。

(3) 数字化

模拟芯片的输入和输出均为模拟信号，其控制内核也以模拟电路居多，引入数字控制器内核能够实现在同类常规模拟芯片中难以实现的功能。近年来凭借调试灵活、响应快速、高集成度以及高度可控的优势，以数字控制内核为特点的新一代数模混合芯片以高端服务器和通信设备应用为主导，逐步拓展至其他更多应用领域，已显示出良好的发展势头。

(4) 智能化

随着电子系统越来越复杂，模拟芯片电路设计也变得更为复杂，这导致了更长的设计周期、更高的开发成本以及更大的错误风险。AI技术的出现，有望解决传统的芯片设计难题，并通过“AI+EDA”的方式，不仅为集成电路设计行业在效率上带来了显著提升，同时也将实现模拟芯片设计质量和生产力跨越式的突破。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年 增减(%)	2023年
总资产	1,755,951,840.90	1,459,684,256.26	20.30	1,441,737,084.97
归属于上市公司股东的净资产	1,406,987,823.83	1,355,209,778.39	3.82	1,326,035,275.03
营业收入	683,486,122.92	688,291,018.89	-0.70	578,471,063.67
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	673,186,015.55	684,959,319.39	-1.72	576,112,586.85
利润总额	2,645,673.97	-36,463,420.23	不适用	-37,689,845.85
归属于上市公司股东的净利润	12,075,419.97	-17,170,922.88	不适用	-19,072,672.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,502,719.23	-46,282,314.78	不适用	-58,565,821.83
经营活动产生的现金流量净额	64,254,485.48	3,415,609.95	1,781.20	-14,971,530.12

加权平均净资产收益率 (%)	0.87	-1.22	增加2.09个百分点	-1.39
基本每股收益 (元 / 股)	0.17	-0.25	不适用	-0.28
稀释每股收益 (元 / 股)	0.17	-0.24	不适用	-0.27
研发投入占营业收入的比例 (%)	22.54	25.60	减少3.06个百分点	27.54

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	123,029,499.17	159,553,067.01	178,904,998.02	221,998,558.72
归属于上市公司股东的净利润	-13,132,453.82	4,317,878.18	6,021,577.67	14,868,417.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-15,355,536.60	834,437.78	1,054,237.97	9,964,141.62
经营活动产生的现金流量净额	14,288,011.77	-10,136,250.74	17,373,000.40	42,729,724.05

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4、 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	6,191
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,031
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）							0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数（户）							0
前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 （%）	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
谢朋村	78,000	12,844,050	18.39	0	无	0	境内自 然人
苏州方广二期创业投 资合伙企业（有限合 伙）	-1,396,756	5,746,244	8.23	0	无	0	其他
新余市凯维思企业管 理中心（有限合伙）	0	5,001,950	7.16	0	无	0	其他
新余市卡维斯特企业 管理中心（有限合伙）	0	4,633,900	6.64	0	无	0	其他
张波	0	4,285,700	6.14	0	无	0	境内自 然人
苑成军	-2,793,512	3,972,673	5.69	0	无	0	境内自 然人
新余市卡纬特企业管 理中心（有限合伙）	0	3,312,300	4.74	0	无	0	其他
喻辉洁	0	2,142,850	3.07	0	质押	400,000	境内自 然人
北京丰汇投资管理有 限公司	1,404,921	1,404,921	2.01	0	无	0	境内非 国有法 人
中国建设银行股份有 限公司一诺安多策略 混合型证券投资基金	373,265	373,265	0.53	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、谢朋村担任三个员工持股平台卡纬特、卡维						

	斯特、凯维思的执行事务合伙人； 2、除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

存托凭证持有人情况

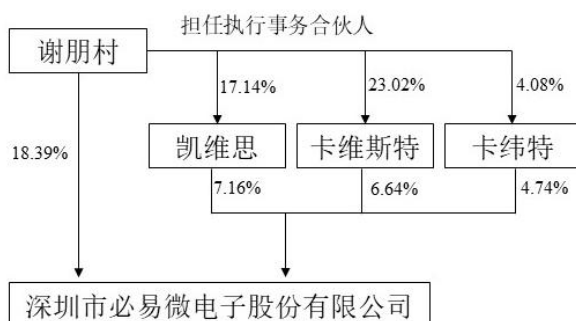
适用 不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

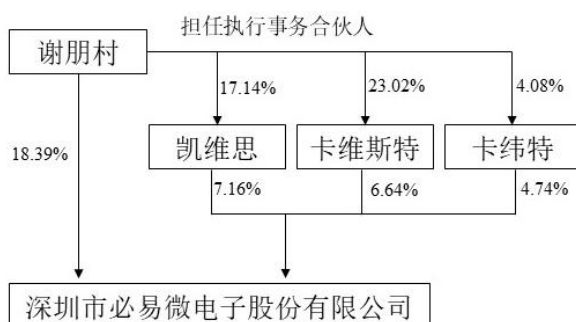
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5、公司债券情况

适用 不适用

第三节 重要事项

1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

具体内容参见公司 2025 年年度报告之“二、经营情况讨论与分析”。

2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用